

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ФОТОТРАНЗИСТОР НА ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ ZnSe—GaAs

Жук Б. В., Зленко А. А., Прохоров А. М., Разов Е. Н.,
Щербаков Е. А.

Реализован фототранзистор на $n-p-n$ -гетероструктуре ZnSe—GaAs в режиме тока, ограниченного пространственным зарядом в эмиттерном переходе. Проведены теоретические оценки предельного быстродействия такого фототранзистора. Экспериментально получена чувствительность 100 A/Bт на частоте 200 МГц.

Гетероструктурные фототранзисторы (ГФТ) перспективны для создания фотоприемников с внутренним усилением и малым уровнем собственных шумов. В основном усилия исследователей направлены на создание ГФТ для практически интересного спектрального диапазона 800—1500 нм. Этот диапазон важен для оптических систем связи и обработки информации. В ряде работ сообщалось о создании ГФТ на основе соединений Al_{1-x}Ga_xAs (GaAlAs—GaAs [1, 2] и InGaAsP—InP [3, 4]). Основным недостатком предыдущих работ по ГФТ является невысокое быстродействие при больших коэффициентах усиления, связанное с большой величиной емкости перехода эмиттер—база. В работах [1—4] получены значения чувствительности 100—500 A/Bт. В то же время временное разрешение составляло в лучшем случае 50—100 нс для транзисторов с «плавающей» базой при мощности падающего излучения на ГФТ в диапазоне 1—10 мкВт. При уменьшении падающей мощности временные разрешение резко ухудшалось.

Такие характеристики фототранзисторов, в особенности временное разрешение, не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к фотоприемникам для систем связи и других целей.

Рассмотрим механизм работы $n-p-n$ -ГФТ с тонкой «плавающей» базой (рис. 1). На ГФТ подано рабочее смещение, обратное для коллекторного перехода. Свет, поглощаясь в узкозонной базе и в запорном слое перехода база—коллектор, рождает электронно-дырочные пары. Дырки двигаются под действием поля в базу и, накапливаясь в ней, понижают барьер для протекания электронов из эмиттера в коллектор. После окончания светового импульса происходит релаксация избыточных дырок в базе с электронами, протекающими через базу, и восстановление первоначального барьера в ГФТ.

Пусть τ_p — время жизни избыточных дырок в базе. Будем считать, что коэффициент усиления транзистора по току $\alpha \gg 1$, τ_n — время жизни электронов в базе, W — толщина базы, S — площадь ГФТ, P_{cb} — постоянная мощность падающего света, η — квантовая эффективность процесса поглощения света, $h\nu$ — энергия кванта регистрируемого света, φ — высота барьера эмиттер—база при данной мощности P_{cb} . Тогда величина тока эмиттер—коллектор

$$I_{col} \cong vqS n_6 (1 - \gamma), \quad \gamma = W/\tau_n v,$$

где v — средняя скорость электронов в базе, q — заряд электрона, n_6 — концентрация электронов в базе. При $\alpha \gg 1$ величина $\gamma \ll 1$. Концентрация из-

быточных дырок в базе $p_6 = P_{cb} \eta \tau_p / h\nu SW$, причем при $p_6 \gg n_b \tau_p = \tau_n p_6 / n_b$. Тогда чувствительность ГФТ

$$\frac{dI_{kol}}{dP_{cb}} \cong \frac{\nu \tau_n}{W} \frac{P_{cb} q \eta}{h\nu},$$

где $\nu \tau_n / W = \alpha$, τ_n — время жизни электронов в базе. При подаче на ГФТ светового импульса передний фронт импульсного отклика ГФТ будет определяться временем пролета электронов базы и запорного слоя переходов база—коллектор и база—эмиттер, а также постоянной времени RC_k (R — сопротивление нагрузки, C_k — емкость коллекторного перехода). Задний же фронт в основном определяет быстродействие ГФТ и связан с временем релаксации избыточных дырок в базе.

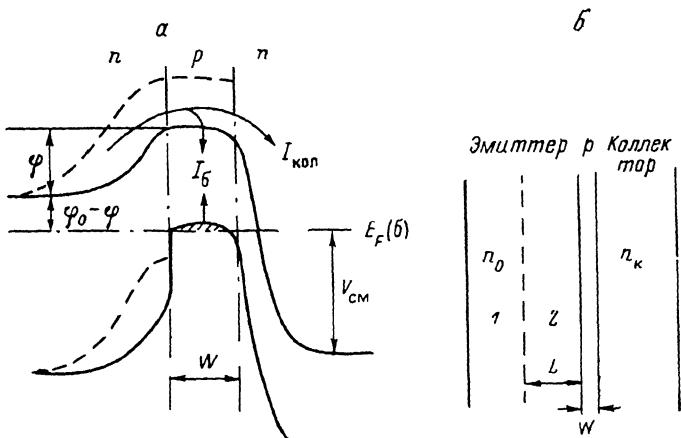


Рис. 1. Зонная диаграмма гетероструктурного фототранзистора (a) и его схема (б).

Пусть на ГФТ падают свет постоянной мощности P_{cb} и импульсы света мощностью $P \ll P_{cb}$. Тогда задний фронт импульса будет иметь экспоненциальный спад с характерным временем τ . Можно показать, что

$$\tau = (C_s + C_k) (d\phi/dI_{kol}) \alpha, \quad (1)$$

где $d\phi/dI_{kol}$ — дифференциальное сопротивление перехода эмиттер—база, C_s и C_k — емкости переходов эмиттер—база, база—коллектор, $C_s + C_k = WqS \times (dP_6/d\phi)$. Из формулы (1) видно, что для определения τ необходимо знать вольтамперную характеристику перехода эмиттер—база и зависимость емкости $(C_s + C_k)$ от потенциала базы. В работе [5] показано, что временные разрешение ГФТ с однородно легированными эмиттером и коллектором при больших коэффициентах усиления ограничивается даже при больших величинах тока за счет увеличения C_s при увеличении тока I_{kol} . Для реальных параметров структуры ГФТ с однородно легированным эмиттером временные разрешение не лучше $10^{-7} \div 10^{-8}$ с при $\alpha > 100$ [5].

Рассмотрим возможность повышения быстродействия ГФТ при сохранении его площади и при наличии двухслойного эмиттера (рис. 1, б). Пусть уровень легирования коллектора — n_k , базы — p . Широкозонный эмиттер состоит из нелегированного слоя толщиной L , прилегающего к гетерогранице, и сильно легированного слоя с легированием, равным $N_d = n_0$ (N_d — концентрация доноров, n_0 — концентрация электронов, $p \gg n_k$). Будем считать, что $\chi_s = \chi_{b,k}$, т. е. отсутствует разрыв в зоне проводимости между эмиттером и базой. Для определения быстродействия необходимо, согласно (1), знать вольтамперную характеристику $I_{kol}(\phi)$ и зависимость $C_s(\phi)$. В дальнейшем предполагается, что $C_k = \text{const}$, $C_s = S (qn_k \varepsilon_s / 2V)^{1/2}$ (V — смещение, поданное на ГФТ, $V \gg \phi_0$).

При $l_0 \ll L$ (l_0 — длина свободного пробега электронов в слое 2) $I_{kol}(\phi)$ можно определить путем совместного решения диффузационного уравнения и уравнения Пуассона в областях 1 и 2:

$$\varphi(x)''_{xx} = -qN/\varepsilon\varepsilon_0, \\ J = qD_n n_x' + gnu_n \tau_x' \quad (2)$$

где J — плотность тока, N — плотность объемного заряда, n — концентрация электронов. В нелегированном слое $N=n$, в легированном слое $N=n-N_x$. Решение системы различно в зависимости от значения потенциала при $x=L$ на границе эмиттер—база. Можно условно выделить три области для решения системы (2): 1) $q(\varphi-\varphi_1)/kT > 1$ (φ_1 — значение потенциала, при котором $\varphi_x=0$ в точке $x=L$); 2) $\varphi \sim \varphi_1$; 3) $q(\varphi_1-\varphi)/kT \gg 1$ (режим тока, ограниченного пространственным зарядом).

Вольтамперную характеристику в области 1 можно получить путем решения уравнения Пуассона при $I=0$ и далее использовать метод вариации постоянных для нахождения величины I . Решение системы уравнений (2) в области 1 можно получить в аналитическом виде. В результате вольтамперная характеристика в области 1 дается выражением

$$I \approx \frac{qD_n n_0 \exp(-q\varphi/kT)}{L} \frac{q(\varphi-\varphi_1)}{kT}. \quad (3)$$

Рассмотрим решение (2) в области 2. Значение φ_1 определяется из уравнения

$$\frac{L^2}{l_D^2} \frac{2}{\pi} = \exp\left[\frac{q\varphi_1(L)}{kT}\right], \quad l_D = \left(\frac{\varepsilon\varepsilon_0 kT}{q^2 n_0}\right)^{1/2},$$

и величина тока при $\varphi=\varphi_1$ $I_1=\pi u_n \varepsilon \varepsilon_0 L^{-3}$. Можно показать, что при $|\varphi(L)-\varphi_1| \leq (1/2)kT/q$ зависимость тока от $[\varphi(L)-\varphi_1]$ имеет следующий вид:

$$I \approx I_1 \exp\left\{\frac{3q[\varphi(L)-\varphi_1]}{2kT}\right\}. \quad (4)$$

В области 3 реализуется режим тока, ограниченного пространственным зарядом (ОПЗ). В результате

$$I \approx \frac{u_n \varepsilon \varepsilon_0}{2L^3} \frac{9}{8} [\varphi(L)-\varphi_1]^2. \quad (5)$$

Для проверки правильности (3)–(5) нами было проведено также численное решение системы (2) в областях 1–3 при $L=1$ мкм, $u_n=10^3$ см²/В·с. Численный анализ показал достаточно хорошее совпадение значений тока с формулами (3)–(5). Решение системы (2) правомерно при условии линейной зависимости дрейфовой скорости движения электронов от величины поля. Однако известно [6], что происходит насыщение величины дрейфовой скорости движения носителей. Предположим, что зависимость дрейфовой скорости электронов от поля E в слое 2 имеет вид $v_{dp}=u_n E$ при $E > E_{\text{нас}}$ и $v_{dp}=v_{\text{нас}}$ при $E < E_{\text{нас}}$.

Тогда при $I \geq \varepsilon \varepsilon_0 u_n E_{\text{нас}}^2 / 2L = I_{\text{нас}}$ вольтамперная характеристика имеет следующий вид:

$$\varphi_1 - \varphi \approx IL^2 / 2v_{\text{нас}} \varepsilon \varepsilon_0. \quad (6)$$

Для определения величины τ , кроме дифференциального сопротивления, нужно также знать величину C_s . Можно показать, что $C_{s1} = \varepsilon \varepsilon_0 S/L$ в области 1, $C_{s2} = 2C_{s1}$ в области 2, $C_{s3} = (3/2)C_{s1}$ в области 3 и при $I > I_{\text{нас}}$ $C_s = 2C_{s1}$. Таким образом, при $C_s > C_k$ для ГФТ такой конструкции в области 1

$$\tau = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 kT}{ILq} \alpha, \quad (7)$$

в области 2

$$\tau = \frac{4}{3} \frac{\varepsilon \varepsilon_0 kT}{IqL} \alpha, \quad (8)$$

в области 3

$$\tau = \left(\frac{L^3}{2\varepsilon \varepsilon_0 I}\right)^{1/2} \alpha \quad (9)$$

и при $I > I_{\text{нас}}$

$$\tau = \frac{L}{V_{\text{нас}}} \alpha. \quad (10)$$

Из (7)–(10) следует, что для ГФТ в режиме тока ОПЗ, как и для ГФТ с однородно легированным эмиттером, быстродействие улучшается с увеличением плотности тока, протекающего через ГФТ, и достигает предельного значения $\tau = L\alpha/v_{\text{нас}}$. Выражение (10) было получено для случая, когда зависимость дрейфовой скорости от величины поля имеет простейший вид. Реально эта зависимость определяется механизмом рассеяния горячих носителей в материале эмиттера и имеет более сложный вид.

Задача получения вольтамперной характеристики в режиме ОПЗ при учете разогрева носителей в слое ОПЗ была решена численными методами в работе [7]. Сравнение численных результатов [7] с выражением (6) показывает, что формула (6) достаточно хорошо отражает ситуацию при $I \geq I_{\text{нас}}$.

Оценим величину τ для реальных параметров структуры. Пусть $u = 10^3 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$, $v_{\text{нас}} \approx 10^7 \text{ см}/\text{с}$, тогда при $L \sim 1 \div 2 \text{ мкм}$ $I_{\text{нас}} \approx$

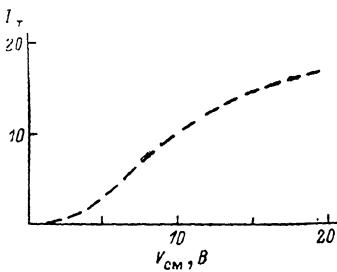


Рис. 2. Зависимость темнового тока ГФТ от напряжения смещения $V_{\text{см}}$.

Площадь ГФТ $2 \cdot 10^{-3} \text{ см}^2$.

$\approx 100 \div 400 \text{ А}/\text{см}^2$, а величина τ при $\alpha = 100$ равна $(1 \div 2) \cdot 10^{-9} \text{ с}$. Характеристикой ГФТ является [4] произведение полосы пропускания $\Delta f \sim \tau^{-1}$ на коэффициент усиления α по току при заданной средней мощности света $P_{\text{св}}$. Если площадь ГФТ составляет $10^{-5} \div 10^{-6} \text{ см}^2$, то при вышеуказанных параметрах и при $P_{\text{св}} = 10^{-5} \div 10^{-6} \text{ мкВт}$ $\Delta f\alpha = 50 \div 100 \text{ ГГц}$, что существенно превышает соответствующую величину для ГФТ с однородно легированным эмиттером ($\Delta f\alpha = 2 \text{ ГГц}$) [4].

Рассмотренная конструкция ГФТ предполагает наличие нелегированного слоя широкозонного материала рядом с сильно легированной узкозонной базой. При этом для реализации режимов работы ГФТ, описанных выше, должны быть выполнены определенные требования на качество слоя толщиной L и на уровень легирования n_0 . Уровень легирования донорами в слое L должен быть, вообще говоря, много меньше, чем величина $I_{\text{нас}}/qv_{\text{нас}}$. В то же время в случае, если «нелегированный» слой является компенсированным полупроводником, концентрация заряженных центров в нем также должна быть много меньше величины $I_{\text{нас}}/qv_{\text{нас}}$. При $L \sim 1 \text{ мкм}$, $v_{\text{нас}} \sim 10^7 \text{ см}/\text{с}$ и $u_n = 10^3 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ величина $I_{\text{нас}}/qv_{\text{нас}}$ порядка 10^{14} см^{-3} .

Для ГФТ [1–4] с большим коэффициентом усиления ($\alpha > 100$) временное разрешение обычно было равно $50 \div 100 \text{ нс}$. Это связано с тем, что в [1–4] использовался однородно легированный эмиттер. Причем обычно уровень легирования эмиттера составлял $(0.1 \div 0.01)p$ (p — уровень легирования базы). Такой уровень легирования эмиттера использовался вынужденно из-за наличия диффузии примеси p -типа из базы в широкозонный эмиттер и образования слоя p -типа в эмиттере [8]. В результате в таких ГФТ C_s была большой и, согласно (1), быстродействие было недостаточно высоким.

Нами для создания ГФТ использованы гетеропереходы ZnSe—GaAs, полученные МОС гидридным способом без газа-носителя [9]. В отличие от гетероструктур типа $A^{III}B^V$ рост ZnSe на GaAs осуществлялся при температурах $350 \div 370^\circ\text{C}$, поэтому диффузия играет меньшую роль при росте таких гетероструктур. Кроме того, известно, что получение ZnSe в виде материала p -типа с концентрацией дырок более $10^{12} \div 10^{13} \text{ см}^{-3}$ — сложная задача из-за известного эффекта самокомпенсации в широкозонных соединениях $A^{II}B^{VI}$. Таким образом, в отличие от гетероструктур $A^{III}B^V$ в гетероструктурах $A^{II}B^{VI} \text{— } A^{III}B^V$ не может быть слоя p -типа со значительной концентрацией акцепторов вблизи гетерограницы.

В качестве подложки в изготовленном ГФТ использовался GaAs *n*-типа с концентрацией носителей $5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$; на эту подложку был нанесен слой GaAs толщиной 7 мкм *n*-типа ($n = 5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$). Путем обработки такой структуры в парах цинка на поверхности был создан слой *p*-типа толщиной 100–200 Å с концентрацией носителей $\sim 10^{20} \text{ см}^{-3}$. Далее на GaAs при 370 °C наращивался слой нелегированного ZnSe толщиной 1–2 мкм. Концентрация носителей в этом слое была менее $5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, последний слой ZnSe толщиной 1 мкм имел уровень легирования $5 \cdot 10^{18} \div 10^{19} \text{ см}^{-3}$ и удельное сопротивление около

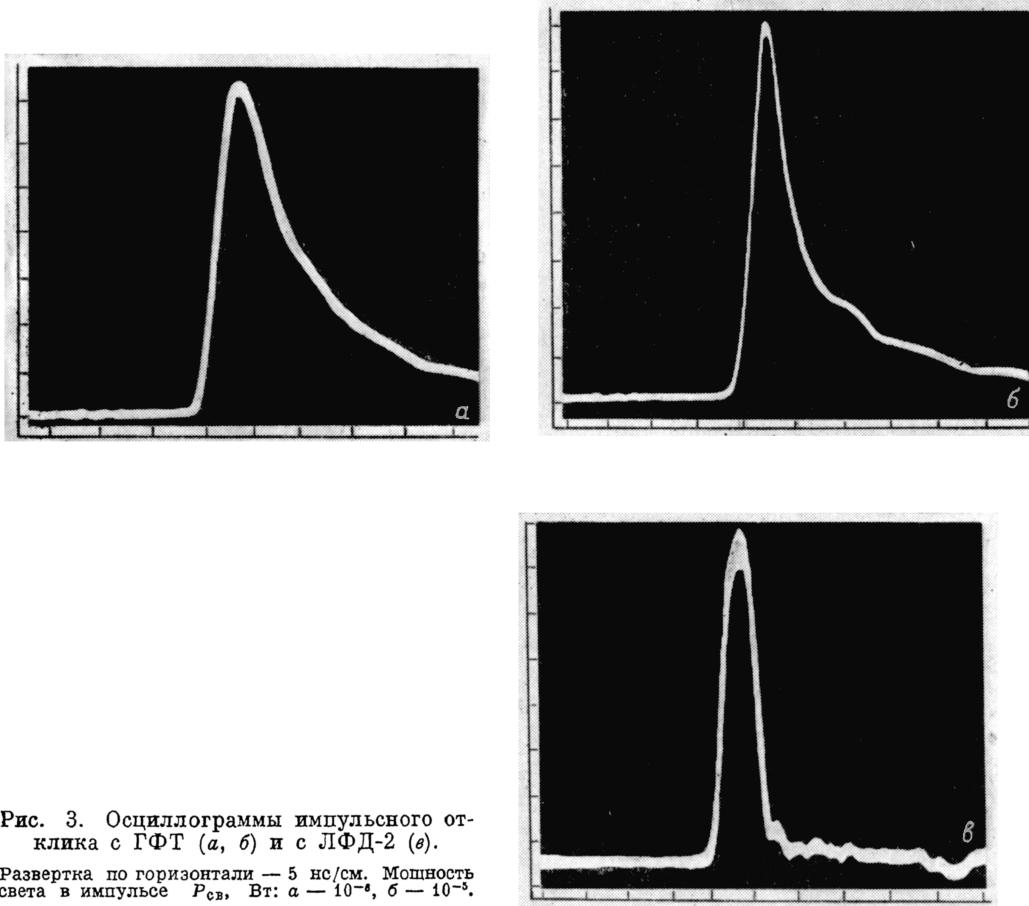


Рис. 3. Осциллограммы импульсного отклика с ГФТ (*a*, *b*) и с ЛФД-2 (*c*).

Развертка по горизонтали — 5 нс/см. Мощность света в импульсе $P_{\text{сп}}$, Вт: *a* — 10^{-6} , *b* — 10^{-5} .

10^{-3} Ом·см. Из такой структуры были изготовлены ГФТ площадью менее 10^{-5} см^2 . Для ГФТ измерялись темновые токи, чувствительность и быстродействие. На рис. 2 показана зависимость плотности темнового тока от напряжения смещения $V_{\text{см}}$ на ГФТ. Чувствительность ГФТ по постоянному току для света с длиной волны $\lambda = 0.84$ мкм составляла $300 \div 1000 \text{ А/Вт}$ в зависимости от экземпляра ГФТ. Чувствительность не изменялась в интервале мощностей света $10^{-8} \div 10^{-4}$ Вт. Измерение быстродействия ГФТ проводилось с помощью полупроводникового лазера на основе GaAlAs с длиной волны генерации 0.84 мкм. Был измерен импульсный отклик при различной мощности падающего на ГФТ света при $V_{\text{см}} = 18$ В. Длительность и форма импульса лазера контролировались с помощью германиевого лавинного фотодиода ЛФД-2 с чувствительностью 5 А/Вт и полосой пропускания 1 ГГц. Сигнал ЛФД усиливался усилителем с коэффициентом усиления 27 дБ, а сигнал с ГФТ подавался на осциллограф без усиления. Нагрузка в обоих случаях составляла 50 Ом. На рис. 3, *a*, *b* показан импульсный отклик ГФТ при различной мощности света в импульсе при отсутствии постоянной подсветки на ГФТ. При наличии

постоянной подсветки быстродействие прибора улучшалось. На рис. 4 показана осциллограмма сигнала с ЛФД-2 и с ГФТ при импульсной мощности на уровне $5 \cdot 10^{-6}$ Вт и постоянной мощности света $3 \cdot 10^{-6}$ Вт. При этом на ЛФД-2 и на ГФТ попадал сигнал одинаковой мощности. Как видно из рис. 4, чувствительность ГФТ составляет 120 А/Вт.

Из рис. 4 видно, что передний фронт импульсного отклика ГФТ повторяет передний фронт сигнала, а задний фронт импульса спадает с характерным временем ~ 2 нс.

Для использованного нами слоя ZnSe подвижность составляет 600 см 2 /В·с [10]. Считая, что

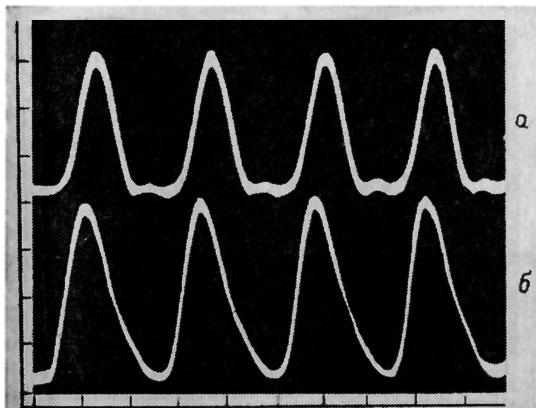


Рис. 4. Осциллограммы сигнала с ЛФД-2 (а) и с ГФТ (б) при постоянной подсветке.

Развертка по горизонтали — 2 нс/см, по вертикали — 10 мВ/см.

для ZnSe $v_{\text{нос}} = 10^7$ см/с, получим, что для режима работы ГФТ, соответствующего приведенному на рис. 4, величина $I_{\text{нос}}$ и полученное временное разрешение удовлетворительно совпадают с формулой (10).

Следует отметить, что в настоящей статье мы не касались свойств базового слоя, которые также играют существенную роль в работе ГФТ, и не рассматривали шумы ГФТ. Эти вопросы будут затронуты в следующем сообщении.

В заключение авторы выражают благодарность Г. П. Шипуло за внимание и интерес к работе, а также И. А. Жукову за помощь в работе.

Л и т е р а т у р а

- [1] Milano R. A., Windhorn T. H., Anderson E. R. et al. — Appl. Phys. Lett., 1979, v. 39, N 6, p. 562—564.
- [2] Scavennec A., Ankzi D., Besombes C. et al. — Electron. Lett., 1983, v. 19, N 8, p. 394—396.
- [3] Campbell J. C., Dentai A. G., Burrus C. A., Fergusson J. F. — IEEE J. Quant. Electron., 1981, v. QE-17, N 2, p. 264—268.
- [4] Tobe M., Amemiya Y., Sakai S., Umeno M. — Appl. Phys. Lett., 1980, v. 37, N 1, p. 7375.
- [5] Milano R. A., Dapkus P. D., Stillman G. E. — IEEE Trans. Electron. Dev., 1982, v. EQ-29, N 2, p. 266—271.
- [6] Зеегер К. Физика полупроводников. М., 1977. 615 с.
- [7] Stratton R., Jones E. L. — J. Appl. Phys., 1967, v. 38, N 12, p. 4596—4600.
- [8] Miller D. L., Asbeck P. M. — J. Appl. Phys., 1985, v. 57, N 6, p. 1816—1820.
- [9] Жук Б. В., Зленко А. А. — В кн.: Применение МОС для получения неорганических покрытий и материалов / Под ред. Г. А. Разуваева. М., 1986, с. 152—170.
- [10] Zhuk B. V., Zhukov I. A., Zlenko A. A. — Sol. St. Electron., 1986, v. 29, N 2, p. 247—250.